



「景気動向は悪くなく、半導体問題も自動車や家電製品で使われてお

いる一般の半導体は不足気味だが、当

社の主要需要分野であるスマートフォンやゲーム機向け高

性能半導体は高水準の生産をキープしている。当社は受注残を多く抱えて

おり、生産が需要に追いついていない状況。来期（2024年3月期）のマーケット環境も一段と好転するだろう」と語るのは、日本铸造の鷺尾勝

社長。

▽：22年4～12月期連

結決算は前年同期比で增收・減益。23年3月期通期見通しは前回予想から利益を下方修正している。素形材部門で合金鉄などの原材料資材価格や電力費が高いレベルで推移し、限界利益が悪化した。「原材料をはじめとする資源や電気、ガスなどの価格が値上がりしてお

り、製造コストを圧迫。製品価格への転嫁を進めていくが、反映が遅れている。」と課題を見据える。

▽：日本铸造は工場のDX（デジタルトランスフォーメーション）化を目指し

て最新IT技術を導入し、設備のIoT（モノのインターネット）化を推進することによって、铸造体制を進化させていく。「すべては生産性改善やコスト削減のため。これまで手掛けたものは着実に成果を出していくため、利益率向上につなげたい」と収益改善に向

（濱）